

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-036

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提条件

以下假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代表对公司 2026 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业发展情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行方案于 2026 年 9 月末实施完成；该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册

并实际发行完成时间为准；

3、根据公司 2025 年年报，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-10,178.78 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-18,418.80 万元；

4、假设公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2025 年假定的基础上持平、亏损增长 10%和亏损减少 10%；

5、假设在预测公司总股本时，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 17,112.51 万股为基础，仅考虑本次发行股票数量对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；

6、假设本次预计发行股份数量不超过 51,337,521 股（含本数，最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应由董事会根据股东会授权根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；

7、假设在本次发行董事会决议日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项；在预测公司发行在外的普通股时，未考虑除本次发行股份之外其他因素对发行在外的普通股的影响；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响；不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2025 年度 /2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
期末股本总额（万股）	17,112.51	17,112.51	22,246.26
假设 1：公司 2026 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净亏损和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净亏损与 2025 年度持平			
归属于普通股股东的净利润（万元）	-10,178.78	-10,178.78	-10,178.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	-18,418.80	-18,418.80	-18,418.80
基本每股收益（元/股）	-0.5981	-0.5990	-0.5570

扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	-1.0823	-1.0840	-1.0079
稀释每股收益(元/股)	-0.5981	-0.5990	-0.5570
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	-1.0823	-1.0840	-1.0079
假设 2: 公司 2026 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净亏损和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净亏损较 2025 年度均增长 10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-10,178.78	-11,196.66	-11,196.66
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-18,418.80	-20,260.67	-20,260.67
基本每股收益(元/股)	-0.5981	-0.6589	-0.6127
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	-1.0823	-1.1924	-1.1086
稀释每股收益(元/股)	-0.5981	-0.6589	-0.6127
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	-1.0823	-1.1924	-1.1086
假设 3: 公司 2026 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净亏损和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净亏损较 2025 年度均减少 10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-10,178.78	-9,160.90	-9,160.90
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-18,418.80	-16,576.92	-16,576.92
基本每股收益(元/股)	-0.5981	-0.5391	-0.5013
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	-1.0823	-0.9756	-0.9071
稀释每股收益(元/股)	-0.5981	-0.5391	-0.5013
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	-1.0823	-0.9756	-0.9071

注 1: 基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》《企业会计准则第 34 号——每股收益》及其应用指南等有关规定测算。

注 2: 上述计算已考虑公司回购专户已回购股份数。

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票实施完毕、募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但由于募集资金使用产生的经济效益需要一定的过程和时间,如果短期内公司净利润未能实现相应幅度的增长,股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非公司的

盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等于公司对未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合产业发展趋势和公司战略规划，有利于提高公司整体竞争力，增强公司盈利能力和持续经营能力，进一步巩固公司行业地位。本次发行的必要性和合理性分析等具体说明详见《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行拟募集资金计划用于广芯微特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工项目和补充流动资金。上述募集资金投资项目主要聚焦公司功率半导体核心业务，旨在进一步增强公司在高端特色工艺晶圆代工业务的产能布局，募投项目实施后，将进一步丰富产品矩阵，拓宽客户覆盖范围，并增强公司晶圆代工业务以及整体功率半导体业务的规模效应和协同效应，发挥其在公司功率半导体业务中的协同牵引作用，树立公司在行业内的产业影响力与核心竞争力，筑牢功率半导体业务发展基座，进而带动整个 smart IDM 模式的高效运转，符合公司“深耕 AiDC，聚焦功率半导体”的战略规划和整体发展目标。综上所述，本次募投项目与公司现有主业具有明显的延续性和协同效应，有助于提升公司在功率半导体领域的核心竞争力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司高级管理人员及核心技术人员在功率半导体领域具备深厚的行业积淀，团队汇聚了来自国内外知名高校的专家学者与拥有多年实战经验的专业人才。

其中，多位成员长期从事功率半导体前沿技术研究，并积累了丰富的产品设计、生产运营及市场拓展经验，全面掌握从研发到生产的先进技术，并且在 6 英寸高端特色工艺晶圆代工产线的建设、运营及优化方面已取得了良好成果，并与本次募投项目的需求高度契合。此外，随着募投项目的逐步推进，公司将持续加强人才队伍建设，进一步优化和扩充专业团队，为项目顺利实施提供坚实的人才保障。

2、技术储备

公司专注于 AiDC 和功率半导体技术，结合自身二十年的行业沉淀，截至 2025 年末，公司已拥有 120 项专利，其中包括 58 项发明专利、50 项实用新型专利和 12 项外观设计专利，此外，公司拥有 31 项软件著作权、16 项集成电路布图设计权。在功率半导体领域，公司已完成从芯片设计、硅片材料、晶圆代工到背道工艺等关键环节的产业布局，各环节均实现稳定量产，并已形成多项自主核心技术与完善的知识产权体系。基于以上深厚的技术积累与完整的产业链布局，公司已具备支持募投项目顺利实施的充分技术条件，能够有效保障项目推进，降低相关技术风险。

3、市场储备

公司在功率半导体领域已建立较强的市场品牌认知与产业基础。通过持续构建自主可控的 smart IDM 生态体系，公司完成了从设计、材料、制造到关键工艺的全产业链关键环节布局，成为国内少数实现功率半导体核心供应链自主可控的上市公司之一，具备显著的行业竞争优势。在本次募投项目重点关注的功率半导体器件领域，其控股子公司广芯微确立了以“定制化代工”为核心、以市场需求和产品开发为导向的运营策略。广芯微依托成熟稳定的研发制造体系及先进的特色工艺平台，构建了显著的核心竞争优势，当前产品组合包括 MFER、VDMOS、IGBT 及 BCD 等系列，广泛应用于高可靠性要求场景。目前，广芯微正处于产能快速爬升阶段，本次募投项目顺利实施后，公司月产能预计将提升 6 万片，从而大幅增强市场供应能力，更好地响应并满足持续增长的下游客户需求。在能源结构转型加速、AI 算力数据中心电源需求激增以及高压轨道交通、特高压电力系统等关键领域对功率半导体分立器件与电源管理芯片需求持续扩大的行业背景下，公司将进一步依托其在行业中的优势地位和全产业链协同资源，积极把握市场机遇，拓展业务版图，不断提升市场份额与行业影

响力，这为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实基础。

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施

公司本次发行后，发行当年每股收益和净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺通过加大市场开拓力度、提高募集资金使用效率、优化内部控制、增强盈利能力等措施，以弥补即期回报的摊薄影响，具体措施如下：

（一）推动业务发展，提高经营效率和盈利能力

公司将坚定执行“深耕 AiDC，聚焦功率半导体”的双轮驱动战略，依托 AiDC 业务形成的稳定现金流和市场规模，为功率半导体业务的研发投入与产能扩张提供持续资金保障，构建 smart IDM 生态圈；同时，借助功率半导体领域积累的技术、供应链资源和产业生态，反向赋能 AiDC 业务向更高集成度和智能化的半导体技术方向升级，构建双产业成长曲线。公司将持续跟踪行业趋势，积极把握市场机遇，通过加强研发团队建设、提升自主创新能力，不断增强技术储备；着力优化生产工艺与产品结构，在有效控制成本的基础上，推出更具性价比与差异化的产品，提升产品附加值与市场适应性，进而增强持续盈利能力；提高公司治理水平，合理运用各种融资工具，控制资金成本，有效控制企业管理和经营风险。

（二）积极推进募投项目建设，尽快实现募集资金使用效益

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战略规划，具有良好的市场前景与经济效益。公司董事会已对项目可行性进行充分论证。在募集资金到位前，公司将提前调配资源，积极开展前期投入工作；募集资金到位后，公司将科学统筹、加快推进项目建设，在确保质量的前提下力争早日投产并实现预期效益，从而提升对股东的回报，降低本次发行可能带来的即期回报摊薄风险。

（三）严格执行利润分配制度，给予投资者合理回报

公司现行有效的《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。为切实保护中小股东利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

等相关法律法规，公司制定了《深圳市民德电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，就未来三年股利分配政策、利润分配原则、决策机制和利润分配形式等内容做出明确规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划。本公司高度重视投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

未来，若上述制度与届时有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件存在不一致之处，上市公司将严格遵守相关法律法规及《公司章程》等内部治理文件的规定，及时对相关制度进行修订和完善，以确保其持续合规有效。

（四）优化公司治理结构，保证募集资金规范使用

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

六、公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、本人承诺将依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2026年6月8日